

成都银河磁体股份有限公司

关于全资子公司竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开的第五届董事会第三次会议和2016年11月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本议案具体内容详见公司2016年10月18日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

公司于2017年3月9日取得了由郫县市场和质量监督管理局颁发的全资子公司“成都银磁材料有限公司”的营业执照并及时进行了公告，2018年5月25日，成都银磁材料有限公司营业执照部分内容变更，公司于2018年5月29日披露了《关于全资子公司变更营业执照的公告》。

2018年10月，公司全资子公司成都银磁材料有限公司参与了国有土地使用权拍卖活动并于2018年10月25日与成都市郫都区国土资源局签订了《挂牌出让国有建设用土地使用权成交确认书》。2018年11月7日，成都银磁材料有限公司与成都市郫都区国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，2018年11月13日，公司收到经双方签订完成的合同。现将土地使用权出让合同主要内容公告如下：

1、宗地编号：510124002012GB00039

2、宗地位置：成都市郫都区德源镇寿增村一、二社、村民委员会

3、宗地面积：56374.69 平方米

4、宗地用途：工业用地

5、出让年限：20 年

6、土地使用权出让价款：人民币 8,515,393.4 元（大写：捌佰伍拾壹万伍仟叁佰玖拾叁圆肆角）。

备查文件：

- 1、《挂牌出让国有建设用土使用权成交确认书》。
- 2、《国有建设用地使用权出让合同》、《国有建设用地使用权出让合同补充条款》。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日